

10月30日(木) 13:50-16:45

セッションチェアマン： 森川 泰宏(株)アルバック)・藤原 健典(東レ(株))

◆ 半導体実装技術・マーケットトレンド(仮題)



株式会社 SBR テクノロジー
代表取締役
西尾 俊彦

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

- 1988 年：日本 IBM(株)半導体研究所
- 1993 年：同上 1 先端実装技術アプリケーション開発
- 2003 年：IBM Distinguished Engineer (技術理事)
- 2011 年：STATSChipPAC Ltd.
- 2013 年：同日本法人代表
- 2016 年 1 月：株式会社 SBR テクノロジー 設立

◆ ラピダスの実装戦略(仮題)

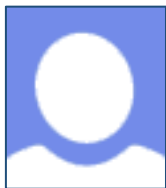


ラピダス株式会社
3D アセンブリー本部
フェロー
野中 敏央

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 半導体パッケージの動向(仮題)



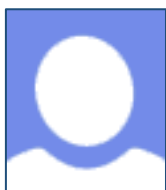
日本サムスン株式会社

古谷 俊樹

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

◆ 光電融合の実装技術(仮題)



慶応義塾大学
理工学部 物理情報工学科
教授
石樽 崇明

[講演要旨]

[講演者プロフィール]

※本講演に興味を持たれた方は、こちらの講演もご覧になっています。

【E-2】 光電融合

【E-3】 先端 PKG